

古河電気工業(株) 事業 IR 説明会 質疑応答録 (要旨)

日時：2026 年 6 月 4 日 (木) 14:30 - 15:45

内容：情報コンポーネント領域

説明者：執行役員専務 情報コンポーネント領域長 大野 良次

執行役員 AT・機能樹脂事業部門長 矢野 正三

執行役員 サーマル・電子部品事業部門長 川畑 賢也

メモリーディスク事業部門長 森 高志

銅箔事業部門長 齊藤 孝史

執行役員 ファイテル製品事業部門長 小神野 毅

光電融合デバイス事業部門長 高木 啓史

陪席者：代表取締役兼執行役員常務 CFO 青島 弘治

Q：サーマルの能力増強について、今回示された立ち上がりの速さ、規模、収益性が想像を上回る。サプライチェーンや顧客側の受注動向、本当に需要があるのか、また収益性や技術的な差別化も含めて教えてほしい。

A：水冷プロジェクトは約 2 年半前にアワードを受けて開始した。当初から大規模だったが、市場拡大に伴い、既存プロジェクトから派生案件や新規案件が広がり、現在の規模に拡大している。
当社は設計協力や試作を重ねてきており、顧客との開発プロセスの中で案件が大きく膨らんだ。利益率自体が大きく変わったわけではないが、立ち上がり局面であることを踏まえて価格設定している。

Q：サーマル事業において、御社が差別化されている点、あるいは選ばれている背景は何か。総合的な技術力やサービス面も含めて教えてほしい。

A：複数社によるコンペティションの中で、当社の熱設計に関する知見や設計協力の実績が評価された。
空冷時代から培った熱設計に加え、水冷に必要な圧力損失の低減や水流の均一化といった熱流体の知見も強みである。さらに、顧客所要に応じた工場拡張により、十分な供給能力を確保できる点も評価されている。

Q：銅箔について、火災事故後に電解銅箔全体の能力が限られる中、高周波対応銅箔への置き換えで収益性を高めていると理解している。2026 年度に高付加価値品比率 65%を計画する中で、今後の需要増にどう対応するのか。能力拡張や HVLP5 への対応状況も教えてほしい。

A：2019 年の台湾拠点での火災以降、電解銅箔全体のキャパシティは若干低下している。加えて、高周波回路用銅箔は製造の難易度高く、供給能力には制約がある。
当社は製品ポートフォリオ転換を進め、高周波回路箔、その中で HVLP 銅箔の HVLP4 に現在注力している。今後については、需要の動向、顧客からのご要求を踏まえ、様々な選択肢から最適な生産体制を検討する。HVLP5 についても開発・顧客評価を進めているが、上市時期についてはコメントを控える。

Q：銅箔の高付加価値品の定義は何か。また、高付加価値品比率の 2024 年度、2025 年度の推移と、2026 年度の計画に加え、現在の競争環境を教えてください。

A：銅箔の高付加価値品は、AI サーバ・データセンタ向けの高周波回路用銅箔を中心に、HVLP1 から HVLP4 までを含む。加えて、半導体パッケージ向けやハイエンド FPC 用の銅箔なども対象としている。

高付加価値品の比率は、2024 年度 40%、2025 年度 54%と推移し、2026 年度は 65%以上を計画している。HVLP4 は難易度が高く、日本メーカーが中心だが、韓国・台湾勢も技術水準を上げてきている。当社は品質・生産体制を強化して対応する。

Q：高付加価値品の中での HVLP4 比率について、2025 年度で 50%という説明があったが、どのような推移になっているのか。

A：HVLP4 の比率は 2025 年下半年期から急増している。年度平均では 50%程度だが、下半期以降、足元ではそれをかなり上回る水準になっている。

Q：サーマルについて、2030 年度に水冷で 4,000 億円という目標の達成時期が早まっているのか。また、派生案件による上積みが見えているのか。さらに、特定プロジェクトが終わると需要が減少するリスクはあるのか。

A：現在のプロジェクトが終われば需要がなくなるわけではなく、後継案件や複数顧客からの案件がある。

「プロジェクト」は実態として製品ラインナップに近く、後継ラインナップが続くと見ている。2030 年度 4,000 億円については、少なくとも確保した上で、さらにどれだけ上積みできるかが課題である。

Q：各主要製品における当社のマーケットポジションについて、市場拡大に沿って成長するのか、それとも市場を上回る形でポジションアップを狙うのか。サーマル、ファイテルなどの競争環境も含めて教えてください。

A：現在の市場は、限られたパイを奪い合う状況ではなく、データセンタ関連需要が大きく拡大している。当社としては、この成長の波をどう取り込むかが重要である。

例えばファイテルについても、市場要求が供給能力を上回っていると見ており、技術開発や工場新設により成長を取り込む方針である。高出力 DFB レーザチップ、ラマン光源用レーザー、SOA など、供給できる企業が限られており、当社が強いポジションを維持している。

Q：伸びる市場に対応するため、サーマル以外の領域でも供給能力を短期間で伸ばす余地はあるのか。今後の追加投資や柔軟な対応力について教えてください。

A：サーマルとファイテルでは、すでに能力増強を進めている。その他の部門でも、顧客からの確度の高い情報やフォーキャストをもとに投資判断を行っている。

市場要求が当社能力を超える場合には、事業特性を踏まえつつ、必要な手立てを講じて柔軟に対応

していく。

Q：銅箔事業について、HVLP4 の需要拡大により製品構成が改善したようだが、足元の決算の状況について開示可能な範囲で教えてほしい。また、高付加価値品比率 65%を計画する中、さらに引き上げる施策や柔軟性はあるのか。

A：HVLP4 の需要拡大により、銅箔事業の売上高、営業利益額、売上高営業利益率は従来から改善している。また、足元では 2025 年第 4 四半期の状態を継続している。

一方、2025 年度上期に影響のあった台湾ドル高といった為替要因や、高騰が続く銅価、原油などのエネルギーコストといった各種リスクを織り込んで 2026 年度の計画を策定した。足元ではこれらの要因がすべて同時に発現するリスクは小さくなく、上振れの可能性もあると見ている。

Q：FFOC について、前期は下期に黒字化した可能性がある一方、通期では厳しい状況と見ている。2026 年度以降、光電融合や薄膜 LN などの可能性をどの程度期待してよいのか。

A：FFOC は前年度下期に黒字化したものの、事業としてはまだ厳しい状況である。今期は既存デバイスを中心に、下げ止まった段階と見ている。

一方で、今後は光電融合に向けた新製品の立ち上げ期にある。特に薄膜 LN 変調器は、高速通信需要の中でポテンシャルが見直されており、今期の上市と、その後の量産立ち上げが重要なポイントである。

Q：2028 年度にセグメント利益 990 億円を目指す中で、サーマル以外の製品では、どの製品の利益貢献が大きくなるのか。順位感を教えてほしい。

A：明確な順位付けは難しいが、サーマルが大きな割合を占めることは確かである。

サーマル以外では、光デバイス領域の引き合いが強く、生産体制を整えながら大きな事業に育てていく方針であり、2 番手はここになるのではないかと見ている。

Q：能力増強投資を積極的に進める中で、投資の刈り取りや資金面について、投資負担を顧客からしっかりと回収できるのか。価格転嫁や長期契約などの考え方を教えてほしい。

A：サーマルは投資規模が大きいですが、回収スピードは早いと見ている。価格を上げて投資回収を早める戦略も含まれている。その他の事業でも、長期契約、前受け金などを顧客と協議し、投資回収の確度を高めていく考えである。

以上